

第 13 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 28 年 5 月 23 日(月) 10:30~16:00

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 2 階 201 大会議室 (東京都中央区)

時間	題 目	講 演 者
	司会 山内 啓 (群馬工業高等専門学校)	
10:30~ 11:50	『マイクロ・ナノ医療デバイスの実装技術』 (40 分)	慶應義塾大学 ○三木 則尚
	Mate2016 受賞講演 『異相界面現象を利用した銀および 銅系導電性接着剤の材料設計』 (40 分)	群馬大学 ○井上 雅博
11:50~ 12:50	昼 食 休 憩	
12:50~ 13:00	委 員 会 議 事	
	司会 山口 敦史 (パナソニック(株))	
13:00~ 14:10	Mate2016 受賞講演 『鉛フリーはんだ接合部の鉛直方向割れ 耐性評価』 (30 分)	三菱電機(株) ○田中 陽、福本 晃久、遠藤 加寿代、 田屋 昌樹、山崎 浩次、西川 和康
	Mate2016 受賞講演 『無電解 Ni-B めっき UBM の はんだバリア特性と接合強度の検討』 (40 分)	(株)富士通研究所 ○森田 将、赤松 俊也、作山 誠樹
14:10~ 14:20	休 憩	
	司会 西川 宏 (大阪大学)	
14:20~ 15:40	『高機能なハイブリッド界面創製のための 低温大気圧表面改質技術』 (40 分)	国立研究開発法人 物質・材料研究機構 ○重藤 暁津
	『高次ナノ構造体の形成と分子センシング への応用』 (40分)	兵庫県立大学 ○山口 明啓、福岡 隆夫、内海 裕一
15:40~ 16:00	表 彰 式	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。